

翱捷科技科创板成功上市，光大控股 斩获新年首个 IPO

2022 年 1 月 14 日，光大控股旗下光控华登全球基金一期（「光控华登基金」）投资企业——翱捷科技股份有限公司（688220.SH，「翱捷科技」）在上海科创板成功发行上市，成为国内通讯基带芯片领域第一家 A 股上市企业。光控华登基金于 2018 年 6 月联合领投翱捷科技 B 轮融资，该项目是光大控股在通讯半导体芯片领域的重要布局。



翱捷科技于 2015 年 4 月在上海成立，以成为世界级芯片公司作为发展目标，是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。公司专注于无线通信芯片的研发和技术创新，同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。公司各类芯片产品下游应用场景广阔，可应用于以手机、智能可穿戴设备为代表的消费电子市场及以智慧安防、智能家居为代表的智能物联网市场。翱捷科技业务经营发展迅猛，最近 3 年收入复合增长率超过 200%，2020 年营业收入规模已达 10.8 亿元人民币。

在不断完善 2G 到 4G 全制式蜂窝通信技术的基础上，翱捷科技研发团队凭借丰富的产品开发经验及高效协同的工作机制，陆续取得诸多技术突破，成为国内少数同时掌握 5G 及 AI 等核心技术的企业。蜂窝移动通信技术是芯片设计领域最先进、最难掌握的技术之一。与 4G 相比，5G 技术融合了先进的信道编解码、调制解调和 Massive MIMO 等技术，能够提供远高于 4G 的传输速率，并在高可靠性、低延时等方面取得了巨大的突破，满足了工业物联网、车联网应用等各新兴应用场景的严苛要求。公司创新性开发了射频、基带一体化的单芯片产品，具备比同类企业更强大的射频基带整合能力。

截至 2021 年 6 月底，翱捷科技已成功量产超过 25 颗全新芯片，产品线全面覆盖蜂窝通信领域、非蜂窝通信领域、AI 领域，实现了在非蜂窝、AI 领域的产品突破，逐步与各领域的龙头企业达成合作关系，并实现大规模销售。公司已成为国内外主流模组厂商的重要供应商，并进入了国家大型电网企业等国内外知名通讯企业的供应链体系。公司的产品已经打入国际巨头长期主导的市场。

光大控股科技投资基金部范文含表示：翱捷科技是国内通信领域基带芯片设计及解决方案供应商龙头，在 5G 商用技术研发方面亦积极布局，公司的产品及技术在消费电子及工业互联网领域皆具有广阔的市场潜力。光控华登基金投资后将进一步赋能企业拓展产业链整合，通过灵活多样的金融服务支持企业加速布局海内外市场，助力公司成长为一家立足中国的世界级芯片企业。

光控华登基金由光大控股和华登国际共同运作，一期总规模为 1.88 亿美元，由光大控股科技投资基金部团队负责投资管理。基于对国产芯片赛道的长期看好，及对翱捷科技创始人团队、产品发展及技术储备的充分认可，光大控股协同华登国际于 2018 年 6 月领投了翱捷科技 B 轮融资。未来，光大控股将继续挖掘半导体芯片赛道的优质投资标的以创造更好的投资回报。翱捷科技是光控华登基金第六个上市项目，此前，光控华登基金已上市的半导体公司还包括半导体清洗设备公司盛美半导体、通信芯片设计企业 Aquantia、汽车电子芯片设计厂商 Indie Semiconductor 及数据芯片龙头企业 Marvell Technology 等。